

深圳市科思科技股份有限公司投资者关系活动记录表

证券简称：科思科技

股票代码：688788

编号：2025-020

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>线上会议</u>
参与单位名称	2025年8月27日 鹏华基金、招商证券自营、国盛证券、鼎萨投资、圆石投资、玖石投资、炬鼎投资、华霖合创、民森投资 2025年8月28日 国盛证券线上会议邀请的分析师和投资者
时间	2025年8月27日 17:30-19:00 2025年8月28日 19:00-20:30
地点	公司23楼会议室、进门财经线上会议
公司接待人员姓名	董事长刘宗林，董事、总经理沈健，副总经理兼董事会秘书陈晨
投资者关系活动主要内容介绍	一、活动内容 董事长刘宗林，董事、总经理沈健，副总经理兼董事会秘书陈晨接待了投资者调研。 二、回答交流 1、请问公司当前的运营情况。 答： 公司当前经营情况一切正常，包括公司的账户都是正常的，项目推进也很顺利，公司整体瞄向的行业包括产业布局，包括关键技术突破和路径都是特别清晰的。公司从成立以来一直关注的以装备为主和以装备技术去拓展更多的产业应用为价值的方向。从公司管理层分析研判来看，未来装备应该向无人化、智能化、体系化来发展，因为未来装备的规模会更大，人工参与程度会逐步降低，智能化水平会逐步提升，所以科思科技对从芯片到设备到系统全方位的关键技术进行了卡位和布局。

2、公司新的管理层的情况

答：公司 2025 年 7 月开展了换届相关工作，经公司董事会提名，由董事会提名委员会进行资格审核，并由 2025 年第一次临时股东大会审议，产生了 6 名董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事一并组成了公司第四届董事会。新一届董事会召开了第一次会议聘任高级管理人员和其他人员。

本次换届工作顺利完成，新一届董事会及经营管理层均具有丰富的行业和管理经验。其中公司董事长刘宗林先生具有深厚的微处理器及集成电路行业技术积累，长期从事芯片研发工作，作为主要参与人多次获得重要奖项。公司董事、总经理沈健先生具有正高级工程师职称，长期从事指挥信息系统总体行业，具备丰富的行业经验。

新管理层将致力于持续推动公司可持续发展，提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力和抗风险能力，提升上市公司价值，维护股东权益。

3、公司半年度经营业绩简介

答：2025 年上半年，公司经营形势向好发展，装备采购重回增长轨道，行业订单出现明显增长，整体呈现复苏趋势。公司实现营业收入 15,445.69 万元，同比上升 40.54%；归母净利润-10,872.15 万元，同比回升 22.23%。公司营业收入大幅上升的主要原因是受终端需求等影响，公司主要产品订单交付同比上升。

报告期内，公司持续保持研发投入水平，研发费用合计 13,110.70 万元，占营业收入的比例为 84.88%。

4、请问公司芯片产品的布局？

答：公司对芯片技术的发展和战略规划是非常重视的，从很早起就开始规划芯片研发事宜，是一个中长期的布局，一直坚持到现在。无人装备或者是未来的装备需要互联互通，需要实现集群管理，所以我们早在 19 年就开始布局通信芯片，并保持了健康的迭代速度，截止目前已逐步推进到第三代。

公司第一代智能无线通信基带芯片已完成各项功能的调测工作，应用于宽带自组网终端、**自组网电台、无线自组网智能驾驶计算平台等多项无线通信整机产品中，同时积极拓展了无人车、无人机、应急类等产品的相关应用。第二代智能无线电基带处理芯片已完成试产流片及测试工作，正在全力推进产品化落地。该芯片的关键设计指标均比第一代芯片有大幅提升，可支持更多的自有通信波形及用户定制波形，支持更先进的编译码方式，支持更丰富的加解密算法；

支持更大规模的组网能力，组网规模比上一代芯片成倍增长。公司第三代智能通信芯片进入开发阶段，旨在低成本、低功耗角度进一步提升芯片领域竞争力。射频收发芯片已经完成流片，正在进行封装以及测试。未来将形成基带通信芯片加射频芯片相结合的一套完整的芯片级解决方案。

此外，公司针对无人化、智能化终端产品使用的NPU芯片已布局和立项正在进行方案论证，如前期验证顺利，将正式开启相关研发工作。

同时我们在人力资源储备上和关键技术攻关上，公司也做了很多布局。公司希望更多的在芯片赛道上进行卡位，来为整个集团的业务形成竞争优势来奠定基础 and 提供支撑。

5、 请问智能无线通信基带芯片是否研发周期过长，以及未来的市场规模？

答：公司第一代智能无线通信基带芯片的研发过程中面临许多困难，期间也攻克了许多技术难题，因此研发周期较长。此外无线通信基带芯片从研发到产品还需要较长的导入期。第二代智能无线电基带处理芯片的技术更加成熟，因此研发周期有所缩减。目前公司与无人设备、应急、矿山等各类应用场景的客户进行对接，芯片的技术指标也得到了客户的认可，公司将努力推动相关市场的突破。

6、 请问公司为什么选择拓展应急行业？

答：公司认为在产品的应用环境上，应急行业与公司之前所处的行业有相似之处，且对产品的技术要求也较为类似，因此公司可以很好地将技术进行迁移，满足应急行业对设备高效响应的要求。在应急行业可以更好地发挥公司的产品优势。公司深度参与了“应急使命·2025”重大演习的筹备工作，成功入选“应急使命·2025”演习装备名录。

7、 请问公司和昇腾合作的情况？

答：公司获得昇腾 APN 钻石部件伙伴授牌，积极融入昇腾的生态，未来公司的智能化装备还将获得昇腾全栈 AI 技术的深度赋能。

8、 请问公司将如何做无人集群装备的产品？

答：科思科技从弱人工智能时代开始就已经布局无人化、智能化产品，如今在强人工智能时代，公司以 ai 大模型为核心，智能算力为基础，智能无线通信基带芯片和射频收发芯片为支持，形成无人集群系统。

	未来，公司沿着通过“核心器件自主化+系统集成智能化+场景落地规模化”的发展路径，持续强化在智能无人领域的先发优势。
附件清单（如有）	无